



HC-269 全水溶性噴錫助焊劑

§產品說明

HC-269 系本公司全新研發之全水溶性助焊劑，此型之助焊劑不含有任何型態之溶劑，因此對於操作人員不具任何之危害，也營造極佳之環境品質。HC-269 因為全水溶性，具絕佳之水洗性，附著於板面的殘餘助焊劑可輕易用水洗淨，可通過嚴苛之 S. E. C. 抗阻測試，離子污染度極低。

HC-269 Wetting 銅面的性能極佳，對於高密度之 BGA 及 SMT PAD 均不會造成任何之露銅現象，極佳之焊錫性可保證出貨之品質。

HC-269 因具高抗熱性，能耐至 260°C 之錫爐溫度，因此錫泥及錫渣比傳統溶劑型助焊劑少很多，可確保錫消耗量降至最低。

HC-269 的高粘度，操作，及中度 PH 值(約 3 左右)能保護所有類型之類型之綠漆，並不受攻擊。

HC-269 是目前市面上最優秀之噴錫用助焊劑。

§產品特點

- 1、低表面張力:11.5DYNE/CM, 使 Flux 易於貫通小孔。
- 2、水洗性極佳:可通過 S. E. C. 測試與離子污染度(Ionic Contamination)測試, 其離子污染度為 2.5 μ gNaCl/inch² 以下(通用標準為 14 μ gNaCl/inch²)。
- 3、與各種形態之綠漆(Solder Mask)皆可兼容, 而不會有傷害表面之現象。
- 4、噴錫過程中, 無溶劑溢出之味道, 不嗆鼻。
- 5、高閃火點(>300°C), 無燃燒之虞。
- 6、噴錫後, 錫面光亮, 平整, 不易出現錫縮現象。
- 7、噴錫時在高溫狀態下, 助焊劑不腐蝕板面之金屬。
- 8、易於控制, 不需其它溶劑稀釋。